EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

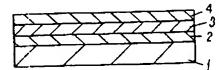
PUBLICATION NUMBER

61041107

PUBLICATION DATE

27-02-86

(D)



APPLICATION DATE

01-08-84

APPLICATION NUMBER

59161858

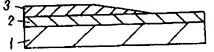
APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR: TERAMOTO IWAO;

INT.CL.

G02B 6/26 G02B 6/12 H01S 3/18

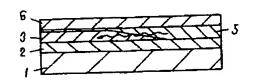
(d)



TITLE

PRODUCTION OF TAPER COUPLING

ELEMENT



ABSTRACT: PURPOSE: To obtain a taper coupling element having a gentle inclination of a tapered part by forming a GaAlAs clad layer, GaAs core layer and GaAlAs cap layer on a (100)GaAs substrate and etching chemically these layers down to the core layer from above the cap layer thereby forming a step.

> CONSTITUTION: The Ga_{0.5}Al_{0.5}As clad layer, the GaAs core layer 3 and the Ga_{0.3}Al_{0.7}As cap layer 4 are successively formed on the (100)GaAs substrate 1. These layers are chemically etched down to the boundary face of the layer 3 and the layer 2 in the direction <01-1> to form the step. After the cap layer 4 is removed by selective etching, the $Ga_{0.95}AI_{0.05}As$ core layer 5 and the $Ga_{0.5}AI_{0.5}As$ clad layer 6 are grown, by which the taper coupling element having the gentle inclination of the taper part is obtd.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

昭61-41107 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int Cl 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)2月27日

6/26 G 02 B

3/18

7529-2H 8507-2H 7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

H 01 S

テーパカップリング素子の製造方法

顧 昭59-161858 ②特

23出 願 昭59(1984)8月1日

四発 明 者 明 者 勿発

明

明

⑫発

⑫発

79発

砂出

79代 理

者

者

者

浜 Œ 渋 谷

 \blacksquare

本

水

藤

和

湇

伊

寺

健 夫 隆

裕

國

優

雄

巌

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 門真市大字門真1006番地

外1名

明 明 者 ⑫発 人 願

松下電器產業株式会社

弁理士 中尾 敏男

1、発明の名称

テーパカップリング素子の製造方法

2、特許請求の範囲

(100) GaAs 基板上に GaALAs クラッド層、 GaAs コア層、GaA&As キャップ層を順次成長さ せる工程と、くロ11>方向に平行に前記キャッ プ層の上から前記コア層まで化学エッチングして 段差を形成する工程とを含むことを特徴とするテ - パカップリング素子の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は光情報処理機器に用いることができる テーパカップリング素子の製造方法に関するもの である。

従来例の構成とその問題点

近年、テーパカップリング素子は元通信におい ての光情達の伝達素子として注目を集めている。 光通信は伝送容量が大きい、減衰が少ない、雑音 に強いなど従来の通信方法に比べて多くの利点を

有している。その中で光通信ネットワークの中で、 光を一方向に安定に伝えるテーパカップリング素 子は従来その製造方法が難しく、新しい製造方法 が求められている。

以下、図面を参照しながら、上述したような従 来のテーパカップリング素子の製造方法について 説明する。

第1図a~cは従来のテーパカップリング素子 の製造方法の各工程における断面図を示すもので ある。第1図において、1はGaAs 基板である。 2はGa_{1-y}Al_vAs クラッド層で、3はGaAs コア 層、4はGa1-xAlxAs コア層で、5はGa1-vAlvAs クラッド層である。

以上のように構成されたテーパカップリング素 子について、以下その動作を説明する。

まず第1図の右方コア層4から入射された光は コア層3との界面の斜面部でカップリンクを生じ コア層3へ伝達される。しかし反対にコア層3例 から入射した光は屈折率の差によりコア層ちへは 伝達されず、光の方向制御を行なりテーパカップ

リング素子が形成される。

しかしながら、第1図に示したような作製方法 では、斜面部の傾きは約60度と非常に急しゅん となり、そのために十分なカップリングが行なわ れず、反射される光が多いという欠点を有してい た。

発明の目的

本発明は上記欠点に鑑み、テーバ部の傾きのゆ 提 るやかなテーパカップリング素子の製造方法を供 するものである。

発明の構成

この目的を達成するために本発明のテーパカップリング素子の製造方法は、(100)GaAs 基板上にGaAlAs クラッド層、GaAs コア層、GaAlAs キャップ層を連続成長させる工程と、〈〇1 1〉方向に平行にキャップ層からコア層まで化学エッチングにより段差を形成する工程とをそなえてから構成されており、この構成によってテーパ部のゆるやかなテーブカップリング素子の作製が可能となる。

び Ga_{O.5}Al_{O.5}Asクラッド層 6 を成長させ、テーパカップリング案子が形成される。

以上のように本実施例によれば、GaAs コソ層 の上にGaAlAs キャップ層をつけ、その上から化 学エッチングを行なうことにより、テーパ部の傾 きの非常にゆるやかなテーパカップリング案子を 作製することができる。

発明の効果

以上のよりに本発明は、コア層の上にGaAlAs キャップ層を形成し、その上からエッチングを行 なり工程を設けることにより、テーパ部の傾きの 非常にゆるやかなテーパカップリンク素子を作製 することができ、その実用的効果は大なるものが ある。

4、図面の簡単な説明

第1図 a ~ c は従来のテーパカップリンク素子の製造方法の各工程における断面図、第2図 a ~ d は本発明の実施例におけるテーパカップリンク素子の製造方法の各工程における断面図である。

1 …… GaAs 基板、2 …… Ga_{1-v}Aℓ_vAs クラッ

実施例の説明

となる。

以下、本発明の一実施例について、図面を参照 しながら説明する。

第2図 a ~ d は本発明の第1の実施例におけるテーパカップリング素子の製造方法の各工程における断面図を示すものである。従来例を示す第1 図と同一箇所には同一番号を付している。
(100) GaAs 基板1上に GaO.5AlO.5Asクラッド層2を2μm、GaAsコア層3を1μm、GaO.3AlO.7Asキャップ層4を1μmの厚さに連続成長を行なり
(第2図 a)。成長後の表面にフォトマスクをかけく011>方向に平行にコア層3とクラッド層2の界面まで化学エッチングにより段差を形成する。エッチャントは硫酸系のものを用い、室温でエッチングを行なり。GaAsコア層3の段差部は第

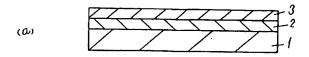
Ga_{O.3}Al_{O.7}Asキャップ層 4 を選択エッチングに より除去した後、Ga_{O.95}Al_{O.05}As コア層 5 及

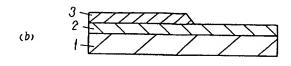
2図 b に示すように傾きの非常にゆるやかな斜面

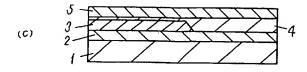
ド層、 3 …… GaAs コア層、 4 …… Ga_{1-z}Al_zAs キャッア層、 5 …… Ga_{1-x}Al_xAs コア層、 6 …… Ga_{1-y}Al_yAs クラッド層。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 図









(b)

(C)

